PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-022381

(43)Date of publication of application: 04.02.1984

(51)Int.Cl.

H01S 3/18 // H01S 3/096

(21)Application number : 57-131186

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

29.07.1982

(72)Inventor: SUGIURA YOSHINORI

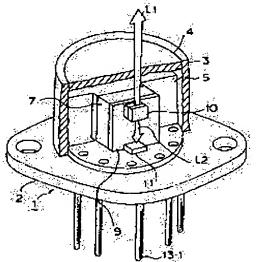
ICHIKAWA JUNJI

(54) SEMICONDUCTOR LASER DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To form the semiconductor laser device of excellent temperature characteristics by arranging a semiconductor laser element near a self—temperature control element in a sealed vessel.

CONSTITUTION: One end of a cylindrical section 3 is sealed by glass 4, and a sealed space is formed by the cylindrical section 3, a base section 2 and glass 4. A heat-insulating block 5, one part thereof is fixed to the cylindrical section 3 and the base section 2, is set up in such a sealed space, and a heating element 7 is fixed onto the block 5. The self-temperature control type heating element of an equipment such as a positive characteristic thermistor is used as the heating element 7. Consequently, the heating element 7 can be kept at a more stable temperature because heat from the outside is interrupted by the heat-insulating block 5 in the heating element 7 and a current value is controlled so that the temperature of element itself is kept constant. On the other hand, a thermal good conductive material 9 is fast stuck and fixed onto the heating element 7, and a



semiconductor laser element 10 is placed and fastened onto said material. Accordingly, only the semiconductor laser element 20 may be heated regarding the heating element 27, small amount of exothermic energy may be sufficient, and thermal capacity can also be reduced, thus enabling the control of the temperature of the element with excellent response.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭59-22381

①Int. Cl.³H 01 S 3/18// H 01 S 3/096

識別記号

庁内整理番号 7377-5F 7377-5F ❸公開 昭和59年(1984)2月4日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 4 頁)

69半導体レーザ装置

@特

願 昭57—131186

22出

昭57(1982)7月29日

⑩発 明 者 杉浦義則

東京都大田区下丸子3丁目30番 2号キャノン株式会社内 切発 明 者 市川潤二

東京都大田区下丸子3丁目30番 2号キャノン株式会社内

切出 願 人 キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号:

個代 理 人 弁理士 大塚康徳

明 細 無

1 発明の名称

半導体レーザ装置

- 2 特許請求の範囲
 - 1 封止容器中において半導体レーザ界子を自己温度制御案子近傍に配置したことを特徴とする半導体レーザ装置。
 - 2 封止容器中に半導体レーザ素子と前記半導体レーザ素子からの出射光を受光する光検出 索子を設け、前記半導体レーザ素子と光検出 索子の近傍に自己温度制御案子を配置したことを特徴とする半導体レーザ装置。

7903-0229 307.6.19

3. 発明の詳細な説明

本発明は半導体レーザ案子からの出射光の波 長変動を少なくすることが出来る半導体レーザ装置 に関するものである。

半導体レーザ索子は周囲温度の変化に伴ない光 出力の変動を生じるばかりか、レーザ発振波長の シフトが生じる。

これらのことから、半導体レーザ 名子を画像記録 等に用いる場合は、 装置に使用される感光体の感 度の波長依存性が大きな問題となる。

従来より、光通信等の分野で半導体レーザ素子を光源として用いることは広く行なわれている。かかる場合に於いて、半導体レーザの光出力を一定パワーに保つ、 Auto Power Control (以下 A P Oと呼ぶ)を採用する事が多い。

このようなAPOに用いる光検出器としては、

特開昭59-22381(2)

使用の容易さの点等から半導体光電変換案子が多用されているが、半導体の光検出器を用いた場合、 光検山器自体の特性の温度変化があり、精度の良い制御の妨げとなる。

特に半導体レーツの発する赤外光領域においては、光検出器の温度による検出感度変化が著しい。 従つて、精度の良い光量制御を行なう為には、光 校出器自体とも恒温槽に入れる等の温度制御を行 なう事が好ましいものである。

又、半導体レーツの出力光の一部を光検山器に入 射させるためには出力光をハーフミラーで分割す る等の光学装置をも必要とするので上述の如き制 御を別個に行なうと半導体レーツ装置の構成が複 雑となる。

本発明はかかる複雑な構成を用いる事なく、温度特性の良好な半導体レーザ装置を提供するもの

従つて発熱素子では断熱プロック 5 によつて外界からの熱が遮断されていて、なおかつ自分自身で一定温度になるよう電流値が制御されるため、より安定した温度に保つことが可能になる。一方前記 発力 5 が 歌僧 固定され、その上に半導体レーザ素子 1 0 が 歌僧 固定されている。かかる半導体レーザ素子 1 0 は例えば第2 図に示す如く、正電極用コンタクト 1 1、 P 層 12、 N 層 1 3、 負電 極用コンタクト 1 4 を 殺 層 して 構成したものであり、前記コンタクト 1 1 , 1 4 間に電を印加することにより、レーザ光 Lu, L2を放射するものである。

第1図において、前記レーザ案子10はレーザ 光 Liが前記ガラス4に向つて放射される如く固定 するものであるが、かかる熱良導材9上において レーザ光 Liの光路上には該レーザ光 Liを受光する であり、以下図面により詳述する。

第1 図は本発明の実施例であつて、半導体レー ザ素子をメタルキャンタイプ I O ケース内に収容 した場合の断面図であり、図面の都合上各案子の リード線は省略してある。

かかる密閉空間内には、その一部を前配円筒部3 及び基台部2に固定した断熱プロック5を設け、 このプロック5上には発熱案子7が固定されてい る。前記発熱案子7は、例えば正特性サーミスタ 等の自己温度制御形発熱案子が用いられる。

如く、フォトダイオードの如き光検出器11を載 置する。13-1で示すのはケース1内に収納された衆子を外部回路に接続する為のピンである。 但し、ケース内の衆子と前記ピンとを接続する接 統線は図面の繁雑化を妨ぐ為に図示していない。

第3図で示すのは前述の如き半導体レーザ装置の制御回路を示すものであり、14-1で示すのは前記光検出器11で検出した検出信号により、前記レーザ素子10を駆動する駆動電源を制御して、レーザ光Li, Liが常に一定となる如く制御する光量制御回路である。

15は発熱素子7の電源で、電源からほぼ一定の 電圧を供給する。このことにより発熱素子7は自 分自身で一定温度になる様に電流がコントロール される。

以上の如き構成によれば、出力レーザ光与は周

特開昭59- 22381(3)

明温度変化、レーザ名子の経年変化によらず常に一定の出力で一定の発掘波長とすることができ、また光検出器を同一の発熱な子上に載置することで極めて正確に制御することができる。

なお、本発明の実施は必ずしも第1図の如きケースを用いなくても良いが第1図の構成ではケース 全体を放熟面として利用出来る。又、ケース内部 な真空封じとすれば、ガラス面の解結防止に有効 である。

第4図は他の東施例を示したもので、比較的温度依存性の少ない光検出器を用いることにより、 半導体レーザ素子のみを発熱素子端部上に戦躍固定した例を示すものである。

半導体レーザ素子をメタルキャンタイプ I O ケース内に収容した場合の断面図であり、図面の都合上各素子のリード級は省略してある。 1 9 で示

すのはメタルキャンタイプのIOケースでありこのケース19は金属より成る悲台部22と敗落台部22と大り成る。かかる円筒部23の一端はガラス24により對止されており、円筒部23と悲台部22とガラス24により密閉空間が形成されている。かかる密閉空間内にはその一部を前配23及び悲台部22には発熱来子27が固定される。この発熱アントロールするところの例えば正特性サーミスタ等の自己温度制御発熱来子27に密音になれる。熱良導材29は前記発熱来子27に密音になれる。熱良導材29は前記発熱来子27に密音になれる。熱度導材29は前記発熱来子27に密音になれる。熱度導材29は前記発熱来子27に密音になれる。熱度導材29は前記発熱来子27に密音になれる。熱度導材29は前記発熱来子27に密音になれる。熱度導材29は前記発熱来子27に密音には半導体レーツ索子20を敬留にある。

前記半導体レーサ票子より発せられた光しを受

この方式によれば発熱案子 2 7 は半導体レーザ 案子 2 0 のみを加熱するだけでよく、発熱エネル ヤーが少なくて済み、また熱容量も少なくするこ とが可能なため応答のよい温度コントロールが可 能となる。

以上述べた如く、本発明によればレーザ光は周 囲温度の影響を受けることなく、又経年変化等の 影響を受けることなく略一定の波長となるもので ある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による半導体レーザ装置を示す 一部断面斜視図、第2図は半導体レーザ素子を示す新視図、第3図は半導体レーザ装置の制御回路 図、第4図は他の実施例による半導体レーザ装置を示す一部断面斜視図である。ここで5,25は断熱プロック、7,27は発熱素子、9,29は熱良導材、10,20は半導体レーザ素子、L1,L1はレーザ光、11,12は光検出器である。

特許出願人 キャノン株式会社 代理人 弁理士 大 塚 康 康

